

Zwischen der Landesregierung von Baden-Württemberg, SUSS MicroTec SE und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird folgender Letter of Intent geschlossen:

Mikroelektronik und Chipindustrie spielen weltweit eine zentrale Rolle für die weiteren Entwicklungschancen von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sind ein Fundament moderner Innovationskraft. Daher weist die Bedeutung dieser Branche weit über die bekannten Technologien hinaus. Im Zentrum steht die Entwicklung von innovativen und intelligenten Technologien, die in Schlüsselindustrien wie der Automobilindustrie, der Medizintechnik oder der Kommunikationstechnologie ebenso wie in Pflege und Logistik eingesetzt werden. Für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und auch in der Robotik ist die Entwicklung spezifischer Chiplösungen zentral.

Für die Landesregierung ist die Stärkung der heimischen Akteure ein wichtiger Bestandteil strategischer Maßnahmen, um technologische Unabhängigkeit und Resilienz Baden-Württembergs, Deutschlands und Europas zu fördern.

Die Unterzeichner dieses Letters of Intent erklären daher ihre Absicht, den Standort Baden-Württemberg technologisch zu stärken, indem die Forschung und wirtschaftliche Aktivität der SUSS MicroTec SE in Baden-Württemberg nachhaltig vorangebracht wird. Dies sehen die Partner als einen wichtigen Schritt zur Unterstützung des Transformationsprozesses der Wirtschaft des Bundeslandes. Ziel ist es, Arbeitsplätze, Wertschöpfung und wirtschaftlichen Erfolg im Land zu steigern und den Unternehmenserfolg zu begleiten.

Das Land Baden-Württemberg wird dazu die Einrichtung einer neuen Professur für Advanced Packaging und Heterointegration sowie die dafür notwendige Ausstattung am KIT finanzieren. Diese Professur soll zentrale Herausforderungen der modernen Mikro- und Nanotechnologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Materialien über Prozesse bis hin zur Systemintegration, abdecken. Das Land wird hierfür einen Betrag von bis zu fünf Millionen Euro bereitstellen. Mit Beendigung der Finanzierung wird die Professur vom KIT auf eine reguläre W3-Stelle im Stellenplan des KIT übernommen. Das KIT wird seine Expertise und Infrastruktur bereitstellen, um die Forschung und Entwicklung im Bereich der Chip-Technologie zu unterstützen. Das KIT wird die neue Professur für Advanced Packaging und Heterointegration organisatorisch aufbauen und betreiben.

SUSS MicroTec SE ist als einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie seit mehreren Jahren auf starkem Wachstumskurs. Zu den Kunden des Unternehmens gehören viele namhafte Hersteller im Halbleiterbereich. Die Anlagen von SUSS MicroTec SE werden beispielsweise für die Produktion von NVIDIA-Chips eingesetzt und sind fester Bestandteil der Produktionskette der leistungsfähigsten High Bandwidth Memory-Speicher Chips, die einen kritischen Bestandteil der Architekturen in der Mikroelektronik für KI darstellen.

Mit dem geplanten Neubau eines Applikations- und Entwicklungszentrums in Karlsruhe, beabsichtigt SUSS MicroTec SE nun ein zentrales Applikationszentrum zu errichten, das die Aktivitäten des Unternehmens bündelt. In diesem Applikationszentrum plant SUSS MicroTec SE, seinen Kunden aus der globalen Halbleiterindustrie und der Forschung die Anlagen und Fähigkeiten der Maschinen von SUSS MicroTec SE zu demonstrieren. Es ist angedacht, dort zudem neue Anlagen zu entwickeln und in enger Zusammenarbeit mit dem KIT neue Prozesse für die Halbleiterfertigung zu erforschen. Basierend auf den Wachstumsambitionen ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren neben der Verlagerung von bestehenden Arbeitsplätzen nach Karlsruhe bis zu ca. 100 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen können. Ziel ist die zeitnahe Ansiedlung von etwa 300 bis 350 Mitarbeitern am Applikations- und Entwicklungszentrum in Karlsruhe, mit weiteren möglichen Ausbaupotentialen abhängig vom Umsatzwachstum.

Die geplante Investition umfasst den Neubau eines Applikations- und Entwicklungszentrums in Karlsruhe nach derzeitigem Planungsstand mit einem geschätzten Gesamtbudget von etwa 45 Millionen Euro. Der Grundstückskauf ist für Anfang Oktober geplant. Noch im Oktober soll die Planung bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Mit dem Spatenstich könnte noch in 2026 gerechnet werden. Ziel der Fertigstellung des Gebäudes ist im Jahr 2028. Die in diesem Letter of Intent beschriebenen Schritte spiegeln den aktuellen, gemeinsam abgestimmten Planungsstand wider. Endgültige Entscheidungen bleiben den jeweils zuständigen Gremien der Parteien vorbehalten.

Alle Partner sind sich einig, dass diese Zusammenarbeit zur Stärkung der Chip-Technologie in Baden-Württemberg und zur Förderung von Forschung und wirtschaftlicher Aktivität beitragen würde. Sie sind bereit, gemeinsam an der Umsetzung dieser Ziele zu arbeiten und ihre Ressourcen und Expertisen einzubringen, um den Erfolg dieses Vorhabens zu sichern.

Stuttgart, den 29. Juli 2026



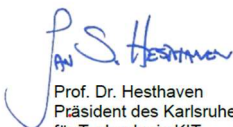
Cem Özdemir MdL
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg



Petra Olschowski MdL
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kuns des Landes Baden-Württemberg



Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
Ministerin für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus des Landes Baden-Württemberg



Prof. Dr. Hesthaven
Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie KIT



Dr. Thomas Rohe
Vorstand Operations (COO)
SUSS MicroTec SE